# Newsletter

## Wir bauen gemeinsam für die Zukunft

8. Ausgabe, Februar 2025

EDITORIAL

**Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Nachbarinnen und Nachbarn,**

an vielen Stellen dieses Newsletters geht es um Nachhaltigkeit – nicht als Schlagwort, sondern als gelebte Verantwortung. Auf den ersten Blick stehen dafür die Chips, die wir bereits heute an der Königsbrücker Straße produzieren – und künftig in der Smart Power Fab. Wir vereinen moderne Halbleitertechnologie mit nachhaltigen Lösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen.

Doch unsere Verantwortung geht weit über die Produkte hinaus: Bereits beim Herstellungsprozess verfolgen wir konsequent Maßnahmen, um Ressourcen wie Energie und Wasser effizienter zu nutzen und unsere Emissionen weiter zu senken – sowohl in den bestehenden Fabriken als auch beim Bau der neuen Smart Power Fab. Inwieweit wir dabei unserem hohen Anspruch gerecht werden, lassen wir durch eine unabhängige Zertifizierung überprüfen.

Nachhaltiges Handeln heißt für uns auch, junge Menschen für sichere, attraktive Berufe in der Entwicklung und Fertigung von Chips auszubilden und später zu beschäftigen. Mit neuen Arbeitsplätzen schaffen wir Perspektiven in der Region und fördern Wachstum und Wohlstand für kommende Generationen.

Eine aufschlussreiche Lektüre wünschen Ihnen

**Thomas Richter und**
**Raik Brettschneider**
Geschäftsführer, Infineon Dresden

**www.infineon.com**



# 4.000 Hände wollen gut koordiniert sein

**Infineon holte führende Ingenieur- und Bauunternehmen für den Neubau der Smart Power Fab ins Boot. Mehr als 2.000 Arbeitskräfte sind inzwischen mit Hochdruck dabei.**

Der Zeitplan ist ambitioniert: Nur rund drei Jahre sind geplant für den Neubau der Smart Power Fab – beginnend vom Spatenstich im Mai 2023 bis zum Produktionsstart 2026. Ein großer Erfahrungsschatz und eine perfekte Koordination sind entscheidende Faktoren dafür, dieses Ziel zu erreichen.

Deshalb setzt Infineon bei dem Bauvorhaben nicht allein auf ein eigenes dafür aufgebautes Projektteam, sondern auf externe Firmen, die über größtes Know-how beim Bau hochkomplexer Fabrikanlagen verfügen. An erster Stelle steht dabei Exyte – ein weltweit agierendes Unternehmen, das auf die Planung und den Bau von Halbleiterfabriken spezialisiert ist.

Bereits viele Monate vor dem Spatenstich begann ein Team von Exyte damit, im Auftrag von Infineon ein grundlegendes Konzept für die Smart Power Fab zu entwickeln. Parallel dazu baute Infineon das von Holger Hasse geleitete Projektteam auf. Es bildet die Schnittstelle zwischen den Expertinnen und Experten der bestehenden Chipproduktion und den externen Unternehmen.

»

Fortsetzung Seite 1

Diese Aufgabenteilung stellt sicher, dass der Neubau die speziellen Anforderungen erfüllt, die zur Herstellung der hochinnovativen Halbleiter notwendig sind.

Mit Exyte hat Infineon ein Unternehmen beauftragt, das seit gut 60 Jahren Reinräume auf der ganzen Welt plant und deren Errichtung begleitet. Diese Rolle übernimmt in Dresden Manuel Magg. Der Projetleiter von Exyte ist seit mehr als einem Jahr auf der Baustelle und koordiniert mittlerweile **ein 150 Personen starkes Team.** Gemeinsam planen, koordinieren und überwachen sie das Baugeschehen.

> **Dabei liegen uns die Themen Arbeitssicherheit und Nachhaltigkeit besonders am Herzen.**
>
> Manuel Magg, Projektleiter von Exyte

Das Bild direkt auf der Baustelle bestimmen weniger die Teams von Infineon und Exyte, sondern diejenigen, die beim Erdaushub, bei den Betonarbeiten oder beim Stahlbau der Dachkonstruktion aktiv sind. Das sind Aufgaben namhafter Unternehmen wie Amand, Strabag und Züblin.

Auch für die inzwischen begonnenen Installationsarbeiten in den Bereichen Elektro, Gas und Wasser sind spezialisierte Firmen zuständig.

Alle Beteiligten eint der Wille, die Herausforderung zu meistern, eine der größten Baustellen Deutschlands innerhalb des geplanten Kosten- und Zeitrahmens fertigzustellen. Zusätzlich gilt es, eine Produktionsstätte zu bauen, die neben den besonderen Anforderungen der Halbleiterindustrie **ein Vorbild sein wird insbesondere bei Effizienz und Nachhaltigkeit.** Das Team von Exyte erfüllt bei diesem ambitionierten Bauvorhaben nicht nur die Rolle, die Gebäude und technischen Anlagen zu planen, den Bau zu koordinieren und zu überwachen. Auch die Inbetriebnahme der Infrastruktur für Abluft, Chemikalien, Gase und Wasser übernehmen die Expertinnen und Experten des Dienstleisters.




Außerhalb der Baustelle ist diese Vielfalt der verschiedenen Gewerke nur schwer zu erkennen. Nur einige Firmenlogos auf Baufahrzeugen, Kränen und Baucontainern deuten auf dieses komplexe Geschehen hin. Inzwischen sind die Rohbauarbeiten zu mehr als zwei Dritteln fertig, im Frühjahr beginnt die **Installation der Produktionstechnik.**

> **Wir managen derzeit eine der größten Baustellen in Deutschland und ich bin begeistert, wie gut unser Projekt im Plan liegt.**
>
> Holger Hasse, Projekteiter Smart Power Fab bei Infineon

## Amand

**Aufgabe:** Aushub der Baugrube unmittelbar neben den Produktionsgebäuden von Infineon.

**Mitarbeitende:** ca. 60

**Volumen:** rund 1.100.000 Tonnen Boden und Fels,
Grundfläche der Baugrube:
etwa 22.500 Quadratmeter,
Abtragstiefe: bis 27 Meter

**Zeitraum:** Aushub von
Frühjahr 2023,
Verfüllung bis Herbst 2025

## Exyte

**Aufgaben:** Als Generalübernehmer verantwortlich für Analysen der Kundenanforderungen, Masterplanung, Design und Engineering sowie Baubegleitung bis zur schlüsselfertigen Übergabe an Infineon, einschließlich Installation von High-tech-Anlagen von Gas- und Chemikalienversorgungssystemen.

**Mitarbeitende:** 150, davon
90 in der Bauplanung und
60 in der Projekt- und Bauleitung.
Insgesamt sind etwa
100 Exyte-Mitarbeitende direkt
auf dem Infineon-Areal tätig.

**Zeitraum:** 2023 bis 2026

## Strabag / Züblin

**Aufgaben:** Die beiden Konzernunternehmen sind zuständig für die erweiterten Rohbauarbeiten, für die Dach- und Fassadenkonstruktion einschließlich des teilweisen Innenausbaus jedoch ohne haustechnische Gewerke. Die Arbeiten erfolgen in einem Mehrschichtsystem.

**Mitarbeitende:** 1.500 inklusive Nachunternehmer.

**Volumen:** 150.000 Kubikmeter Transportbeton und
25.000 Tonnen Bewehrungsstahl wurden bereits verbaut;
das Krankonzept sieht bis zu
15 Turmdrehkräne vor.

**Zeitraum:** 2023 bis 2025

# „Ich möchte Mehrwert schaffen“

**Franziska Lindner verantwortet das Qualitätsmanagement beim Bau der Smart Power Fab. Neues auf den Weg zu bringen, motiviert sie jeden Tag.**



Warum passt eine Biologin so gut in das Projektteam der Smart Power Fab? Wer auf die berufliche Laufbahn von Franziska Lindner schaut, findet schnell eine Antwort auf diese Frage: Im Arbeitsalltag und bei den Herausforderungen macht die 35-Jährige keinen Unterschied zwischen dem „Was“ und dem „Wie“.

Nach ihrer Masterarbeit arbeitete sie in einem Leipziger Forschungsinstitut daran, den neuartigen Herstellungsprozess von CAR-T-Zellen für ein hochinnovatives Medikament auch in Deutschland zu etablieren. Damit trug sie dazu bei, das Leben von leukämiekranken Menschen zu retten.

Bereits bei dieser Tätigkeit in Leipzig war sie als stellvertretende Projektleiterin für die Etablierung von Herstellungsprozessen zuständig, bei denen die Qualität eine entscheidende Rolle spielt. Und dabei kommt es nicht allein auf das „Was“ an – die Zell- und Gentherapie –, sondern auch auf das „Wie“: dem Verändern körpereigener Zellen der Kranken in einem Reinraum. Hier werden sie so modifiziert, dass sie die Leukämie aus eigener Kraft bekämpfen. Die dazu notwendigen Abläufe müssen in höchstem Maße zuverlässig und fehlerfrei sein.

Der familiär bedingte Wechsel der Biologin zurück in die Heimatstadt Dresden bescherte ihr die nächste berufliche Herausforderung. Sie begleitete den Aufbau der Herstellung hochwirksamer pflanzlicher Medikamente. Mit ihrem Team führte die junge, zweifache Mutter diese als Leiterin der Herstellung und im Qualitätsmanage
Als Franziska Lindner vom Neubau der Smart Power Fab hörte, erkundigte sie sich sofort bei Infineon, ob es für sie eine Aufgabe in dem Projekt geben könnte. Ihre Motivation überzeugte.

> **Ich liebe die Aufbruchsstimmung und die Energie von Teams, die etwas Neues schaffen.**

Als Qualitätsmanagerin im Projektteam für den Bau der Smart Power Fab ist sie dafür verantwortlich, dass beim Errichten der Gebäude und Produktionsanlagen die Qualität erreicht wird, die in den Projektzielen festgeschrieben ist. Die beinhalten nicht nur die reibungslose Produktion in der notwendigen Qualität und Quantität nach Fertigstellung des Gebäudes, sondern auch den Bauablauf bis zur Inbetriebnahme. Neben den Qualitätsanforderungen ist hierbei der Zeitplan ebenso einzuhalten wie die vorab kalkulierten Kosten.

Die mit dieser Aufgabe verbundenen Herausforderungen passen perfekt zu ihr: „Es ist eine sehr vielfältige Aufgabe und es ist schön zu sehen, wie der Bau jeden Tag wächst.“ Zu den Aufgaben von Franziska Lindner gehört auch die Verantwortung für die unabhängige LEED-Zertifizierung für grünes Bauen. Nach erfolgreichem Abschluss wird Infineon den Nachweis erhalten, dass Design und Bau der Smart Power Fab den Kriterien eines umweltgerechten, gesundheitsfördernden, hocheffizienten und kostensparenden Gebäudes entsprechen. Die Biologin ist sehr glücklich, dass sie für diese Zertifizierung verantwortlich ist. Ihre Motivation: „Ich möchte Mehrwert schaffen“.

# Vom Wafer zum einzelnen Chip



Die feine Chipstruktur, die mit bloßem Auge auf dem fertig prozessierten Wafer erkennbar ist, steht für hunderte oder gar tausende Chips, die später sehr unterschiedliche Aufgaben übernehmen. Um sie einsatzfähig zu machen, bedarf es einer ganzen Reihe an Arbeitsschritten. Zusammengefasst werden diese Schritte **Rückseitenprozesse** genannt. Ein Teil davon – das Schleifen und Separieren der Wafer – findet am Dresdner Standort von Infineon statt. Bis ein einsatzfähiges Produkt an die Kunden von Infineon ausgeliefert werden kann, folgen weitere Prozesse, die andere Unternehmensstandorte übernehmen.



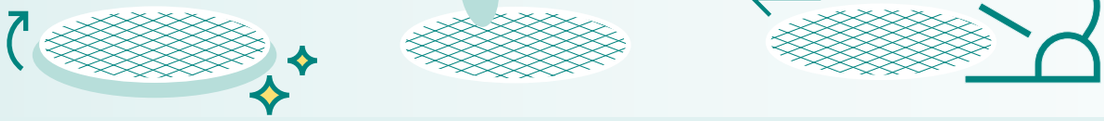
Wafer sind bei der Prozessierung 800 Mikrometer (µm) dick.
Sie werden auf 20 bis 200 µm geschliffen – abgedünnt.
**Bank- und Kreditkarten:**
standardisierte Dicke von 760 µm



50 bis 100 µm beträgt der Abstand zwischen den Chips auf den Wafern.
**Standarddruckpapier:**
etwa 80 bis 120 µm
**Haar (Mensch):**
20–100 µm



15 bis 50 µm stark sind die Scheiben zum Zersägen der Wafer.
**Aluminiumfolien:**
für den Haushalt: 10 bis 25 µm,
Grillfolie: bis zu 50 µm
**Plastiktüten:**
dünne Einwegtüten:
15 bis 50 µm



## 1. Schleifen

Fertig prozessierte 300-Millimeter-Wafer sind etwa 800 Mikrometer (µm) dick – also knapp 0,8 Millimeter. Um die Leitfähigkeit zu erhöhen, werden die Siliziumscheiben am Standort Dresden auf **50 bis 200 Mikrometer** geschliffen. Durch dieses Abdünnen weisen sie nur noch die Stärke von handelsüblichem Kopierpapier auf. Als Schleifmittel dienen  diamantbesetzte Schleifscheiben.

## 2. Sägen

Um die Chips aus den papierdünnen Wafern trennen zu können, werden Letztere auf eine Sägefolie aufgebracht. Gesägt wird mit diamantbeschichteten Stahlsägescheiben, die eine Stärke von **20 bis 25 Mikrometern** aufweisen. Trotz des hohen Tempos von bis zu 20 Zentimetern pro Sekunde arbeiten die Sägen hochpräzise: Der Abstand zwischen den Chips beträgt in der Regel 50 bis 100 Mikrometer.

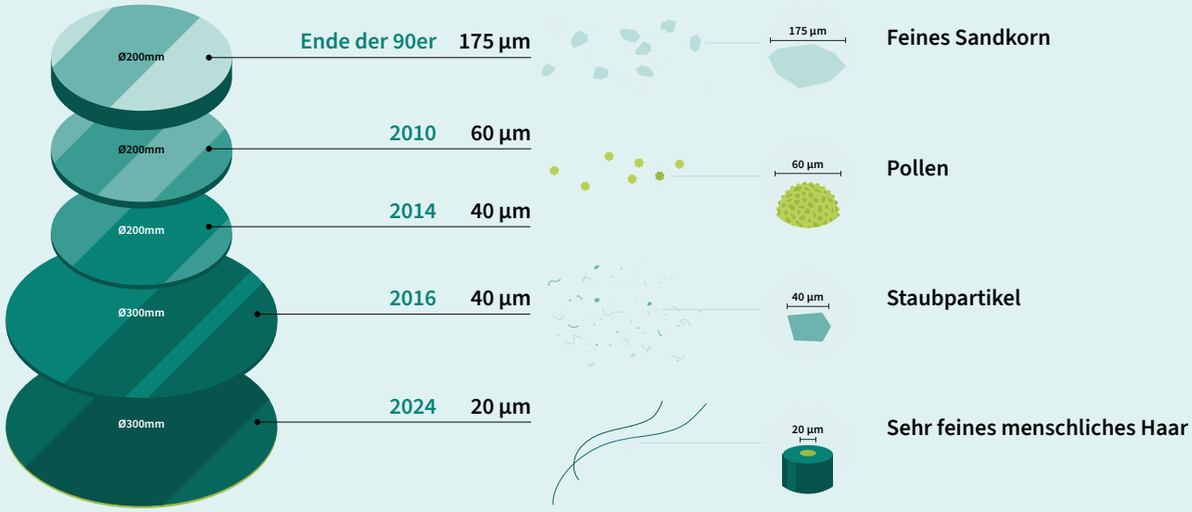
## 3. Inspizieren

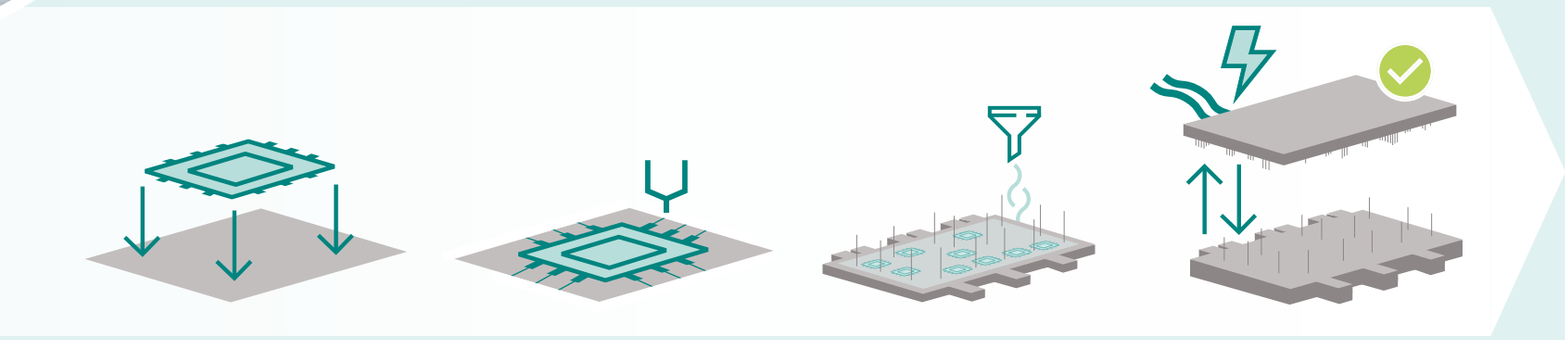
Vor der weiteren Verarbeitung werden die defekten Chips aussortiert. Die **visuelle Inspektion** umfasst die Prüfung auf Risse, Partikel und andere physische Defekte. So wird sichergestellt, dass die Chips korrekt arbeiten.

Frontend-Standort Infineon Dresden



## Wafer werden immer größer und dünner



### 4. Befestigen

Die hauchdünnen Chips brauchen eine feste Basis. Genutzte Materialien sind zumeist **kupferbeschichtete Keramik.** Vorrangig wird ein Lötverfahren genutzt, um den Chip und das mit Anschlussstellen versehene Trägermaterial miteinander zu verbinden. Es folgt eine Kontrolle der Verbindung per Röntgenstrahlen.

### 5. Verbinden

Dünne, **150 bis 400 Mikrometer** starke Drähte verbinden die Kontaktpads der Chips mit den Anschlussstellen des Trägermaterials. Meist sind es Roboter, die die aus Alu und Kupfer bestehenden Leiter an den Kontakten platzieren. Um langlebige und elektrisch stabile Verbindungen herzustellen, wird in der Regel Ultraschall genutzt. Besonders beim Gold-Bonding erfolgt eine Kombination solcher Verfahren.

### 6. Einhausen

Für Anwendungen in Hochleistungsbereichen – beispielsweise in E-Autos oder Windkraftanlagen – setzt Infineon mehrere Chips in ein spezielles Gehäuse.
Um die Chips in den Modulen vor mechanischen Belastungen, Feuchtigkeit und Staub zu schützen, werden sie vergossen. Zum Einsatz kommen dafür sichere Materialien wie **isolierende Silikongele.**

### 7. Letzte Schritte

Nach dem Einhausen werden die **Chips auf Leistung sowie Robustheit** getestet. Es folgen Prüfungen von Funktionalität sowie Leistungsfähigkeit, zum Teil auch bei unterschiedlichen Temperaturen. Im Anschluss wird der Chip mit Angaben zu Typ, Seriennummer und Logo des Herstellers versehen.

# Die Smart Power Fab steht für Nachhaltigkeit

## Infineon strebt mit dem Neubau in Dresden eine LEED-Zertifizierung für grüne Gebäude an.



Bereits bei den ersten Konzepten für die Smart Power Fab war klar, dass sie exemplarisch für die **weltweite Nachhaltigkeitsstrategie von Infineon** steht. Mit Blick auf die zunehmende Verknappung natürlicher Ressourcen als eine der größten globalen Herausforderungen setzt das Unternehmen auf einen möglichst effizienten Einsatz von Energie und Wasser.

Um diesen Anspruch zu erfüllen, will Infineon die Smart Power Fab als erste Produktionsstätte des Konzerns nach den Kriterien für „Leadership in Energy and Environmental Design“ (LEED) zertifizieren lassen. Dies ist ein unabhängiges Nachhaltigkeitssiegel, das weltweit Standards für **umweltfreundliches, ressourcenschonendes sowie nachhaltiges Bauen** definiert und auch den Betrieb von Gebäuden einschließt.

**Was ist LEED?**

- LEED steht für „Leadership in Energy and Environmental Design“.
- Die LEED-Zertifizierung überprüft unabhängig Merkmale, Design, Bau, Wartung, Betrieb und Effektivität grüner Gebäude.
- LEED ist mit rund 200.000 Projekten, darunter mehr als 5.000 Fertigungsanlagen, das weltweit am häufigsten genutzte Bewertungssystem für grüne Gebäude.

**Grüne Gebäude stehen für**

- sinkende $CO_2$-Emissionen,
- kosteneffizienten Bau und Betrieb,
- ein gesünderes Umfeld für Menschen,
- ökologische, soziale und unternehmerische Vorteile.

### Klare Kriterien für ein unabhängiges Urteil

Damit die neue Halbleiterfabrik ein LEED-Zertifikat erhält, muss sie bestimmte Kriterien erfüllen. Viele davon flossen bereits in die Planung der Smart Power Fab ein. Dennoch achtet Infineon bei den laufenden Arbeiten kontinuierlich darauf, die Vorgaben für grüne Gebäude einzuhalten. Dafür zuständig ist Franziska Lindner. Sie ist Qualitätsmanagerin bei Infineon Dresden und koordiniert die Nachhaltigkeitsmaßnahmen für die Planung und den Bau der neuen Fabrik.

Bewertet werden vor allem Maßnahmen, mit denen sich die Effizienz beim Bau – und später in der Produktion – optimieren lassen. Beispiele dafür sind ein möglichst geringer Energieverbrauch, einhergehend mit einem geringeren Ausstoß an Treibhausgasen. Dies stellen unter anderem energieeffiziente Systeme, wie beispielsweise Wärmepumpen und die Nutzung der Wärmerückgewinnung, dar. Bereits heute bezieht Infineon **Strom zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen.** Darüber hinaus wird die Smart Power Fab als erste Fabrik von Infineon im Routinebetrieb ohne Erdgas auskommen.

Wasser ist eine weitere wichtige Ressource, deren effizienter Gebrauch entscheidend für eine erfolgreiche LEED-Zertifizierung ist.

> **Die Smart Power Fab von Infineon wird neue Standards setzen für den effizienten Einsatz wichtiger Ressourcen.**
>
> Thomas Richter, Geschaftsführer, Infineon Dresden

Dazu gehört es, in der Produktion Industriewasser zu nutzen – und kein Trinkwasser. Darüber hinaus verwendet Infineon



eigenes, selbst aufbereitetes Abwasser aus der Produktion für weitere Herstellungsschritte, für Abluftsysteme sowie für Kühltürme. Auch dadurch sinkt der Gesamtwasserverbrauch deutlich. Ein bereits fertiggestellter Speicher liefert Regenwasser für sanitäre Anlagen.

Mit seinem Neubau auf dem bereits vor über 30 Jahren erschlossenen Betriebsgelände setzt Infineon auf einen **geringstmöglichen Flächenverbrauch.** Möglich ist dies unter anderem durch einen auf zwei Ebenen aufgeteilten Reinraum. Der Neubau kann außerdem weitestgehend die bereits vorhandenen Zufahrten nutzen. Dadurch reduziert sich der Flächenverbrauch zusätzlich.

Ein weiteres Anliegen beim Bau der Smart Power Fab ist es, ungeachtet der neu entstehenden Arbeitsplätze das Verkehrsaufkommen zu begrenzen. Infineon unterstützt die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel durch vergünstigte Job-Tickets, Fuß- und Radwege sind an das Betriebsgelände angebunden.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können Fahrräder leasen, für diese werden erheblich mehr Fahrradstellplätze zur Verfügung stehen.



# Mikrotechnologie und Mechatronik hautnah erlernen

## Infineon ermöglicht jungen Leuten bei der Ausbildung praxisnahe Einstiege ins Arbeitsleben.



Durch das besondere Licht im Reinraum schimmert der 200 Millimeter große Wafer goldgelb. Jeder Auszubildende der Mikroelektronik ist bereits im ersten Jahr bei Infineon für eine dieser Siliziumscheiben verantwortlich, auf der jeweils rund 150 Test-Chips entstehen. Maximal sechs Wochen dauert es, bis der Wafer in etwa **180 Einzelschritten** die komplette Prozessierung durchlaufen hat. Zehn bis 15 Schritte davon begleiten die Auszubildenden persönlich. In kleinen Gruppen gehen sie mit Lehrkräften in den Reinraum und lernen die einzelnen Maschinen sowie die einzelnen Schritte kennen, durch die auf einer puren Siliziumscheibe komplexe Chips entstehen.

Ganz im Sinne der Null-Fehler-Policy von Infineon durchlaufen auch die Wafer der Auszubildenden und die darauf entstandenen Chips ausführliche Tests. Danach **können die jungen Leute die komplett verarbeiteten Wafer behalten** – es ist ja ihr „Baby“. Dieses Ausbildungshighlight bietet Infineon seit 2018 an. Möglich ist dies nur dank einer engen Zusammenarbeit der Bereiche Ausbildung, Technologie und Fertigung – ein gutes Beispiel, wie alle Beteiligten von einem gut konzipierten Projekt profitieren. So können sich junge Menschen in einer dreijährigen Ausbildung zu kompetenten, motivierten Mitarbeitenden entwickeln, die künftig in den verschiedensten Bereichen von Infineon arbeiten.

Auch bei der Mechatronik, dem zweiten vom Halbleiterhersteller in Dresden angebotenen Ausbildungsgang, steht eine praxisnahe Ausbildung im Mittelpunkt. Dabei lernt der Berufsnachwuchs, wie innovative Halbleiterprodukte und Mikrosysteme konstruiert und hergestellt werden. Ebenfalls Teil des Aufgabenbereichs der Mechatronik sind Planung und Organisation von Arbeitsabläufen sowie von Versuchsreihen in der Produktion. Neben dem Einrichten von Anlagen und Apparaturen gehören auch das Überwachen, Testen und Prüfen der Fertigungsprozesse zum Profil dieses Berufs. Bestandteil dieser dreieinhalbjährigen Ausbildung sind auch Projekte, bei denen die jungen Leute eigenständig ein Gerät konzipieren und herstellen – wie im Fall der Wafer für die Mikrotechnologen **eine Art Gesellenstück** zum Mitnehmen und Vorzeigen.

Ausbildungsangebote in den Bereichen Mikrotechnologie und Mechatronik (Bevorzugter Start: 11. August 2025)

**Was Infineon jungen Leuten bietet und von ihnen erwartet steht unter:**
www.infineon.com/ausbildung

**Kontakt:**
Ausbildung_Dresden@infineon.com

# Wir sind für Sie da

Infineon hat den Anspruch, bereits den Bau der Smart Power Fab sowie im Anschluss den Betrieb der Produktionsanlagen so nachhaltig wie möglich zu gestalten. Damit verbunden ist aus Sicht von Infineon eine größtmögliche Transparenz. Das gilt auch für die Beziehungen zum Umfeld des Dresdner Unternehmensstandorts.

Der vorliegende Newsletter ist ein Element der Kommunikationsaktivitäten, mit denen Infineon die unmittelbare Nachbarschaft sowie die Einwohner Dresdens über sein ambitioniertes Neubauprojekt informiert.



## Aktionstage Auto-Frühjahrsputz

Die Transporte zur Baustelle der Smart Power Fab über die Königsbrücker und die Karl-Marx-Straße sind immer wieder Anlass für Fragen und Hinweise aus der Anwohnerschaft. **Infineon bedankt sich ausdrücklich** für Ihre Nachsicht und Gelassenheit in den vergangenen Monaten. Als kleines Zeichen des Danks sind Autofahrerinnen und -fahrer herzlich zu den Aktionstagen „Auto-Frühjahrsputz“ eingeladen. An den Sonnabenden, dem 15. und 22. März, können Sie jeweils von 9 bis 17 Uhr die Autowaschanlage der Agip-Tankstelle am Flughafen (Flughafenstraße 81, 01109 Dresden) **kostenlos nutzen.** Bitte buchen Sie ab dem **10. März online einen Termin** unter dem folgenden Link: **www.infineon.com/smartpowerfab**

## Rückblick: Eine kleine Aufmerksamkeit im Advent

Am Vorabend des 1. Advent fand auf dem Hellerauer Markt das traditionelle Erleuchten des Weihnachtsbaums statt. Das Projektteam der Smart Power Fab überraschte die zahlreichen Gäste mit den leckeren **Lebkuchen des Marktbäckers Torsten Eckert.** Natürlich gab es viele Fragen rund um das Bauprojekt, die gern beantwortet wurden. Ein besonderer Dank gilt dem Verein Bürgerschaft Hellerau für die Gelegenheit, das Team und das Bauvorhaben in diesem traditionellen Rahmen vorstellen zu dürfen.

## Bau-Hotline

Für Fragen und Hinweise zum Neubauprojekt Smart Power Fab steht der Dresdner Nachbarschaft eine Hotline zur Verfügung. Anrufe sind jederzeit möglich unter: **0351 886 6066**

## Mailkontakt

Wer sich mit einer E-Mail mit einem Anliegen zur Smart Power Fab melden möchte, schreibt bitte an: **dialog@infineon.com**

Die Smart Power Fab wird gefördert durch die Europäische Union, die Bundesrepublik Deutschland und den Freistaat Sachsen. Die geäußerten Ansichten und Meinungen sind ausschließlich die der Autoren und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten der Europäischen Union oder der Europäischen Kommission wider. Weder die Europäische Union noch die Europäische Kommission können für sie verantwortlich gemacht werden.

Finanziert von der Europäischen Union
NextGenerationEU

Gefördert durch:
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz
aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

SACHSEN
Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes.

IPCEI Microelectronics and Communication Technologies

Infineon Technologies Dresden GmbH & Co. KG
Königsbrücker Str. 180
01099 Dresden

© Infineon Technologies AG
Alle Rechte vorbehalten

Fotos: Infineon Technologies AG / Andreas Scheunert / Ketchum GmbH

Stand: Januar 2025

www.infineon.com/dresden

www.infineon.com/smartpowerfab

www.infineon.com/linkedin
www.infineon.com/facebook
www.infineon.com/twitter
www.infineon.com/youtube